

● レイテックスの装置戦略

正式に米国法人を立ち上げ エッジ検査の文化を広げる

米国法人を設立

レイテックスは2003年8月、米国Oregon州に米国法人「Raytex USA」を設立した。すでに、2002年に同所で現地事務所を設立、サービス・サポートなどを行ってきた。今回の米国法人設立は、単なるサービスサポートだけでなく、ユーザーのニーズを汲み取り、製品開発などに活用する目的もある。米国は新しい技術やプロセスの先進国であり、米国から発信される情報をいち早くキャッチする。また、レイテックスの技術の特徴や現在取り組んでいることなどを発信する役割も持つ。「相互の情報の風通しを良くしたい」（高村社長）という。また、同社の装置を導入しデモを行える体制も整えた。Raytex USAは、従来から働いている人以外にも、エンジニアを増員する予定で、日本から送り込む他、現地採用も行う。当初は数名規模でスタートするが、将来的にはかなりの規模になると想定している。

新製品を相次ぎ投入

「ウェーハ外観検査の自動化をトータルで提供する」というコンセプトに基づき、同社は数多くの装置を開発してきた。まず、ウェーハエッジの検査装置「EdgeScan」を開発、同装置が大ヒットした。ウェーハエッジの検査については、以前よりニーズはあったが、対応できる装置がなかったため、やむなく目視検査を行っていた。レイテックスではレーザーを使用する検査コンセプトを開発、高性能・高速なエッジ検査を可能にした。EdgeScanの登場により、エッジへの注目が高まり、市場は拡大した。これまで60台以上のEdgeScanを納入しており、現在も継続的に受注がある。ほぼ全てのSiウェーハメーカーにEdgeScanを納入しており、Siウェーハのエッジ検査におけるデファクトの地位を築いた。その後も、裏面検査装置やエッジグリップタイプのウェーハエッジ検査装置、端部除外領域検査装置、検査装置への組み込み用ウェーハエッジ検査モジュール、エッ

ジ・裏面検査対応の複合機などを投入、今年も数機種の新製品を発表する予定。

デバイスへの展開図る

Siウェーハにおけるエッジ検査の文化を定着させたレイテックスだが、次のステップとしてデバイスプロセスにおけるエッジ検査を睨んでいる。本格的な300mmウェーハ時代を迎え、エッジの傷などが

原因と見られるウェーハ割れも深刻化してきた。搬送時やプロセス時にウェーハエッジに小さな傷が生じるケースは多い。熱処理やCMP工程でこの傷がウェーハ割れを起こすようだ。まだ完全には解明されていないが、デバイスプロセスにおけるウェーハエッジの検査の必要性が徐々に認識されてきた。

レイテックスでは、デバイスプロセスにおいてもウェーハエッジを検査するという文化を広げていきたいとしている。エッジ検査では、競合メーカーが現れてきているが、気にしてはいないという。特にデバイスプロセスでは対象が多く、複雑なため、同社でもどれくらいのニーズがあるかを掴み切れてはいない。「ウェーハエッジを検査するという文化を定着させることが重要。そのためには競合メーカーが現れてくれた方が良い」（同氏）。まず、市場を大きくすることが先決だという。デバイスプロセス向けでは米国の半導体メーカーが強い興味を示しており、同社では米国法人を通じて展開していく。

レイテックスの会社概要

設立：1988年7月19日
代表者：高村 淳
資本金：2億50万円
売上高：
2002年5月期 10億4000万円
2003年5月期 14億5000万円
事業内容：ウェーハ自動検査装置の製造・販売など



代表取締役社長 高村 淳氏